

深南电路股份有限公司

2020 年度财务预算报告

一、 行业格局及发展趋势

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。其中，中国产值占比超过50%，并且全球产能继续向中国转移的趋势明显。根据Prismark预测，2019-2024年，全球PCB复合增长率为4.3%，中国则将以4.9%的复合增长率保持较快增长。（具体可参见公司《2019年年度报告》“第三节公司业务概要：一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容）。

电子产品将持续向“集成化，自动化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，会促进 PCB 持续向高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化等方向发展，多层板、刚挠结合板、HDI 板、类载板、封装基板等产品的需求量将日益上升。

二、 公司发展战略

公司将持续专注于电子互联领域，围绕核心业务做强做优，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为电子互联技术领导者。

三、 2020 年经营计划

中美经贸摩擦、新型冠状病毒疫情等事件冲击下，全球外部经济、政治环境更具不确定性，经济下行压力加大，公司经营所面临的环境更加复杂。

公司2020年将持续落实“3-In-One”战略，紧紧围绕年度经营目标，把握重点战略机遇期，攻坚克难，积极应对宏观经济不确定因素，重点聚焦提升技术能力、自动化改造、专业产品线建设、管理数字化提升、保障业务连续性等关键工

作，力求实现各项业务稳定较快增长。

PCB业务将继续聚焦5G，紧抓5G通信领域发展机会，保持并持续扩大先发优势。同时，公司将重点开发数据中心、汽车电子等市场，持续深耕工控医疗、航空航天市场；继续强化专业化及自动化工厂建设，打造适应高度自动化的运营管理模式，提升各工厂资源配置效率，并持续完善质量、交付体系建设。

电子装联业务重点立足已有战略客户，持续拓展通信、医疗、汽车、航空航天领域优质项目；重点聚焦设计、工程、供应链等能力提升，加强业务市场一体化管理。

封装基板业务将持续保持细分市场领先优势，大力开拓存储类封装基板等重要市场，推动与国内外关键客户开发与合作，重点推进无锡基板工厂爬坡。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日